



3-Axis Scan Head

Modular, with Integrated Z-Axis

製品の特長

3軸スキャンヘッド Lightning™ II 及び ProSeries 2 は XY 軸スキャンヘッドと Z 軸ダイナミックフォーカシングモジュール (DFM) で構成され、広範囲の加工フィールドや三次元表面におけるレーザ加工システムインテグレーションに最適なソリューションと適応性を提供します。3軸スキャンヘッドは微小なスポットサイズに自動フォーカス、レーザ加工のスピードと品質の向上を提供します。DFM は加工フィールド全体でレーザスポットのフォーカスを確実に維持します。さらに3軸スキャンヘッドでは様々な部品を加工するためにそれぞれに最適化した焦点距離や有効なフィールドサイズを調整することができます。最新の Lightning™ II FX と ProSeries 2 FX は最小限の損失と吸収率を可能にした新しい光学技術を採用し、レーザビームのフォーカス安定性が更に向上しました。

Lightning™ II フルデジタルスキャンヘッドは超高速・高精度・高い位置安定性を実現し24時間以上に渡る高い安定性が要求される3次元レーザ積層造形法・レーザ加工・微細加工などのアプリケーションで実力を発揮します。ProSeries 2 アナログスキャンヘッドはスクライビング・微細加工・高速加工・ソーラー加工などのアプリケーションに対応するコストパフォーマンスに優れたソリューションです。UV から IR までのレーザ波長用ミラーコーティングや光学系オプションを幅広く取り揃えています。

3軸スキャンヘッドの適応性のある最適なフィールドサイズを提供

- 業界最高レベルの高精度走査速度で最大スループットを発揮
- 堅牢設計・多目的のアプリケーションに簡単なジョブの切り替え
- 目的の素材加工に合わせた多様なオプション
- システムの安定性と信頼性でレーザ加工の不稼働時間を削減
- ファイバーレーザ波長アプリケーションのフォーカス安定性が飛躍的に向上

3-Axis Scan Head

Modular, with Integrated Z-Axis

3-Axis Scan Head for CO₂ Lasers (λ: 10.6 μm, 9.4 μm)

概要				スポットサイズ (μm) ¹				トラッキング エラー (ms)
ミラーアパー チャビーム 口径 (mm)	製品 ファミリー	フィールド サイズ範囲 (mm x mm)	入力ビーム 口径 (mm)	フィールド サイズ 200 x 200mm	フィールド サイズ 500 x 500mm	フィールド サイズ 750 x 750mm	フィールド サイズ 1000 x 1000mm	
30mm	Lightning II	100-1000	17	213	465	670	881	0.2
	ProSeries 2							0.4

3-Axis Scan Head for Fiber/YAG Lasers (λ: 1060nm - 1090nm)

概要				スポットサイズ (μm) ¹				トラッキング エラー (ms)
ミラーアパー チャビーム 口径 (mm)	製品 ファミリー	フィールド サイズ範囲 (mm x mm)	入力ビーム 口径 (mm)	フィールド サイズ 100 x 100mm	フィールド サイズ 400 x 400mm	フィールド サイズ 750 x 750mm	フィールド サイズ 1000 x 1000mm	
30mm	Lightning II FX	100-1200	10	13	37	66	87	0.2
	ProSeries 2 FX							0.4

3-Axis Scan Head for Other Lasers (λ: 355nm)

概要				スポットサイズ (μm) ¹				トラッキング エラー (ms)
波長 (ミラー アパーチャ ビーム口径)	製品 ファミリー	フィールド サイズ範囲 (mm x mm)	入力ビーム 口径 (mm)	フィールド サイズ 200 x 200mm	フィールド サイズ 400 x 400mm	フィールド サイズ 600 x 600mm	フィールド サイズ 800 x 800mm	
355nm (20mm)	Lightning II	200-2500	1-3	10	18	23	30	0.2
523nm (20mm)			2-3	15	32	39	53	0.2

注: 仕様は予告なく変更されることがあります。

参考:

1. スポットサイズは1.0のM²値を想定した理論値です。

Cambridge Technology 事業部概要

Cambridge Technologyは50年の経験に基づきガルバノスキャナおよびポリゴンスキャナなどの光学スキャンングコンポーネント・2軸および3軸スキャンヘッド・スキャンングサブシステム・高出力レーザスキャンヘッド・制御ハードウェア・ソフトウェアなどの最先端レーザビーム走査ソリューションを設計・開発・製造しております。レーザシステムメーカーの先端産業機器・エレクトロニクス機器・レーザベースの医療アプリケーションをサポートするOEMスキャンングソリューションを提供しています。Cambridge TechnologyはOEMユーザとパートナーシップを構築し大規模な光学ソリューションから小規模なコンポーネントまでお客様のニーズを満たす製品設計を得意とします。主な取引分野には3次元レーザ積層造形・レーザ加工・レーザマーキング・ピアホール穴あけ加工といった高度先進産業用途、さらにレーザ治療や光コヒーレンストモグラフィー (OCT) などの医療用途があります。

CAMBRIDGE TECHNOLOGY: アメリカ

+1 (781) 266 5800 | support-us@cambridgetechnology.com

CAMBRIDGE TECHNOLOGY: ヨーロッパ・中東・アフリカ

+49 (0)89 31707 0 | support-eu@cambridgetechnology.com

CAMBRIDGE TECHNOLOGY: 日本・韓国

+81 (3) 5753 2462 | support-jp@cambridgetechnology.com

CAMBRIDGE TECHNOLOGY: 中国・シンガポール・マレーシア・タイ・インドネシア

+86 (512) 6283-7080 | support-cn@cambridgetechnology.com



A Novanta Company

www.CambridgeTechnology.com